

研究成果報告書 (掲載期間 2018.11-2019.10)

学術書

- (1) Kim S Siow : Die Attach Materials for High Temperature Applications in Microelectronics Packaging, 第 8 章, Springer, 2019. (著者が多く、全て書くことができません。)
- (2) 山田靖 他 : EV・HEV 向け電子部品、電装品開発とその最新事例, 第 2 章第 11 節, 技術情報協会, 2018. (著者が多く、全て書くことができません。また、監修者はいません)

審査学術論文

- (1) 山田靖, 田根篤, 棚村壽三 : 交通流による空気質予測を用いた車室内換気法, 人間と生活環境, 21 巻, 2019, 1 号, pp. 13-18.

学会発表

- (1) Y. Yamada, K. Hasegawa, Y. Ikeda, Y. Kasagi, K. Katagiri, H. Katou, H. Watanabe, A. Takenaka, H. Nagata, N. Sekine, Y. Sano : Reliability of pressure-free Cu nanoparticle joints for power electronic devices, ESREF 2019 (30th European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis), 2019 年 9 月, Toulouse.
- (2) 山田靖 : パワー半導体実装用接合技術 -Cu ナノ粒子接合と特性評価-, スマートプロセス学会, 第 27 回電子デバイス実装研究委員会, 2019 年 9 月, 大阪.
- (3) 山田靖 : パワーモジュール用実装材料評価プロジェクト (KAMOME-PJ) の活動状況, エレクトロニクス実装学会, 第 33 回エレクトロニクス実装学会春季講演大会, 2019 年 3 月, 東京.